

展示会出展情報

2018年1月22日現在

◆ 2018年 出展予定



SEMICON China 2018

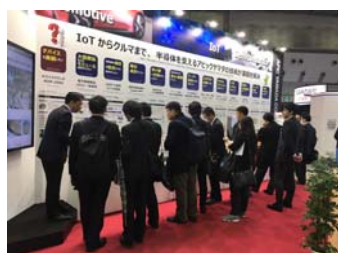
開催日	2018年3月14日(水)～3月16日(金)
会場	Shanghai New International Expo Centre [中国/上海]
小間番号	Hall: N4 #4487

→ [公式サイト](#)

◆ 過去の展示会

ご来場、ありがとうございました。

第19回 半導体・センサ パッケージング技術展 ISP 2018



第19回 半導体・センサパッケージング技術展

開催日	2018年1月17日(水)～1月19日(金)
会場	東京ビッグサイト [東京/有明]
小間番号	東3ホール E23-22
出展内容	IoTからクルマまで、半導体を支えるアピックヤマダの技術が課題を解決

→ [公式サイト](#)

SEMICON JAPAN



セミコンジャパン 2017

開催日	2017年12月13日(水)～12月15日(金)
会場	東京ビッグサイト [東京/有明]
小間番号	東3ホール No.3814 (ミニマルファブ内)
出展内容	ミニマル圧縮モールド成形装置 実演展示

→ [公式サイト](#)



JSTフェア 2017

開催日	2017年8月31日(木)～9月1日(金)
会場	東京ビッグサイト [東京/有明]
小間番号	東展示棟 4ホール
出展内容	エレクトロスプレー繊維加工技術

→ [公式サイト](#)

日本ものづくりワールド 2017 内

第21回 機械要素技術展



第21回 機械要素技術展

開催日	2017年6月21日(水)～6月23日(金)
会場	東京ビッグサイト [東京/有明]
小間番号	No.東70-25 (千曲市産業支援センター ブース内)
出展内容	精密プレス製品、精密成形部品

→ [公式サイト](#)



第31回 最先端実装技術・パッケージング展

31st ADVANCED ELECTRONICS PACKAGING EXHIBITION
主催：一般社団法人エレクトロニクス実装学会 (JIEP)
Sponsored by: Japan Institute of Electronics Packaging



2017 マイクロエレクトロニクスショー

開催日	2017年6月7日(水)～6月9日(金)
会場	東京ビッグサイト [東京/有明]
小間番号	No.東8C-09 (eX-tech 2017 内)
出展内容	成形サンプル及びポスター展示

→ [公式サイト](#)



SEMICON China 2017

開催日	2017年3月14日(火)～3月16日(木)
会場	Shanghai New International Expo Centre [中国/上海]
小間番号	Hall: W4 #4824
出展内容	最新機種 WCM-f400 MS 実機展示

→ [公式サイト](#)

第16回 半導体パッケージング技術展



第18回 半導体パッケージング技術展 (ネブコンジャパン2017内)

開催日	2017年1月18日(水)～1月20日(金)
会場	東京ビッグサイト [東京/有明]
小間番号	西展示棟 W1-42
出展内容	APIC YAMADA TECHNICAL FUSION “パワーデバイス&最先端デバイス”

→ [公式サイト](#)



セミコンジャパン 2016

開催日	2016年12月14日(水)～12月16日(金)
会場	東京ビッグサイト [東京/有明]
小間番号	東2-2844 (ミニマルファブ技術研究組合内)
出展内容	圧縮モールド成形装置 実演展示

→ [公式サイト](#)